

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

公告编号：2024-071

芯联集成电路制造股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/4/15，由董事长丁国兴先生提议
回购方案实施期限	2024/4/13~2025/4/12
预计回购金额	20,000 万元~40,000 万元
回购价格上限	7 元/股
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	9,998.0204 万股
实际回购股数占总股本比例	1.4174%
实际回购金额	39,936.5397 万元
实际回购价格区间	3.47 元/股~4.26 元/股

一、 回购审批情况和回购方案内容

2024 年 4 月 13 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机用于股权激励计划及/或员工持股计划，回购价格不超过人民币 7 元/股（含）；回购资金总额不低于人民币 20,000.00 万元（含），不超过人民币 40,000.00 万元（含）；回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-022）、《芯联集成电路制造股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的

回购报告书》（公告编号：2024-029）。

二、 回购实施情况

公司于 2024 年 5 月 14 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 4,918,982 股，占公司总股本 7,046,641,000 股的比例为 0.0698%，回购成交的最高价为 4.08 元/股，最低价为 4.04 元/股，支付的资金总额为人民币 19,999,992.62 元（不含交易佣金等交易费用）。详见公司于 2024 年 5 月 15 日披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份进展公告》（公告编号：2024-038）。

根据相关规定，公司于 2024 年 5 月 8 日、6 月 4 日、7 月 2 日、7 月 4 日、8 月 2 日、9 月 3 日披露了《芯联集成电路制造股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》。上述具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 99,980,204 股，占公司总股本的 1.4174%，最高成交价为 4.26 元/股，最低成交价为 3.47 元/股，成交总金额为 399,365,397.44 元（不含交易费用），本次回购股份方案已实施完毕。

公司本次实际回购的价格、使用资金总额符合回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

公司本次回购股份使用的资金均为自有资金，不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

三、 回购期间相关主体买卖股票情况

2024 年 4 月 15 日，公司首次披露了以集中竞价交易方式回购股份的方案，详见公司披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-022）。在公司首次披露回购股份事项之日起至发布回购结果暨股份变动公告前一交易日，公司董监高、第一大股东、回购股份提议人均不存在买卖公司股票的行为。

四、 股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
有限售条件流通股份	5,945,947,150	84.39	2,657,697,113	37.68
无限售条件流通股份	1,099,800,000	15.61	4,395,960,000	62.32
其中：回购专用证券账户	0	0	99,980,204	1.4174
股份总数	7,045,747,150	100.00	7,053,657,113	100.00

注 1：公司首次公开发行部分限售股 3,296,160,000 股于 2024 年 5 月 10 日上市流通，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《芯联集成电路制造股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2024-031）。

注 2：2024 年 5 月 7 日，公司第一期股票期权激励计划第一个行权期第四次行权新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次行权的激励对象为 21 人，行权股票数量为 893,850 股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为 2027 年 5 月 7 日（如遇非交易日则顺延）。行权后，公司总股本由 7,045,747,150 股变更为 7,046,641,000 股。上述内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《芯联集成电路制造股份有限公司关于第一期股票期权激励计划第一个行权期第四次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-037）。

注 3：2024 年 6 月 27 日，公司第一期股票期权激励计划第二个行权期第一次行权新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次行权的激励对象为 133 人，行权股票数量为 7,016,113 股，自行权日起三年后可上市流通，预计上市流通时间为 2027 年 6 月 27 日（如遇非交易日则顺延）。行权后，公司总股本由 7,046,641,000 股变更为 7,053,657,113 股。上述内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《芯联集成电路制造股份有限公司关于第一期股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-050）。

五、 已回购股份的处理安排

根据本次股份回购方案，公司本次回购的 99,980,204 股股份，拟用于员工持股计划及/或股权激励，在实施前暂时存放于公司开立的回购专用证券账户，并在

股份回购结果暨股份变动公告日后 3 年内予以转让。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让完毕,尚未转让的回购股份将予以注销。后续,公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2024 年 10 月 9 日